

2026 年 8 月 26 日

各 位

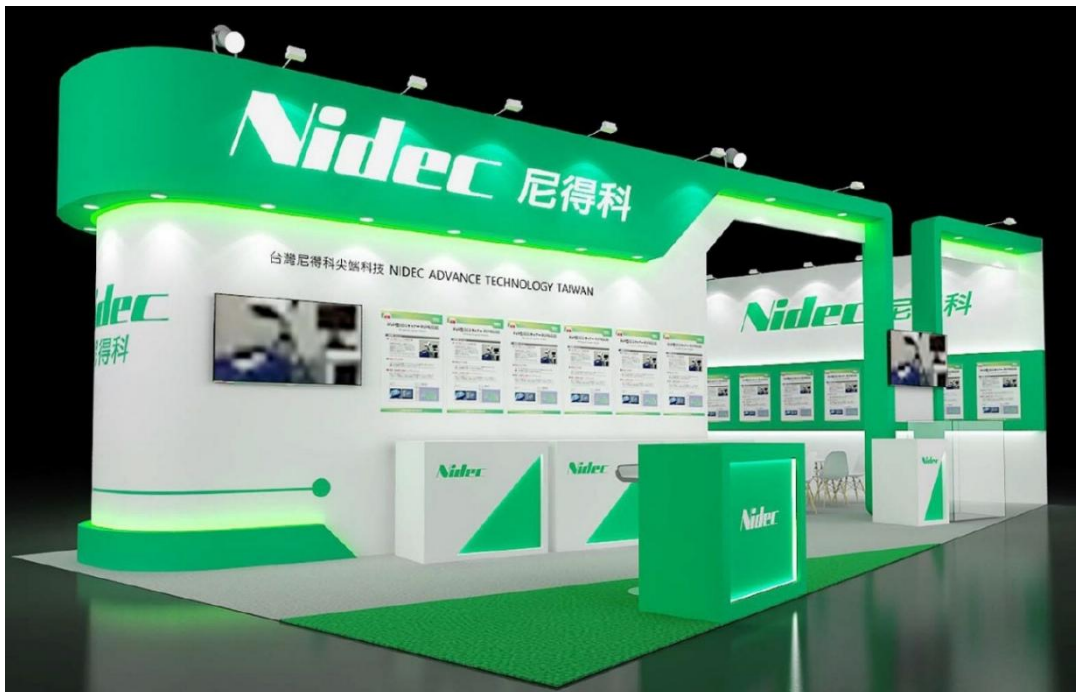
会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社

代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和

所 在 地 京都府向日市ニデックパーク 33 番地 C 棟

SEMICON TAIWAN 2026 への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2026 年 9 月 2 日(水)～9 月 4 日(金)に台北南港展示センター（TaiNEX）で開催される、半導体業界における最新技術と革新を展示するアジア最大級の国際展示会「SEMICON TAIWAN 2026」に出展します。



本展示会は、台湾で最も影響力のある半導体関連イベントであり、本年は「*Transform Tomorrow*」をテーマに 65 カ国から 1,300 社を超える企業が出展を予定しています。

当社は『ONE STOP SOLUTIONS of AI server/EVs』をテーマに、ウエハ検査用治具「プローブカード」の最新ソリューションをはじめ、当社が誇る光学検査技術、電気検査技術、プロービング技術を融合し、ウエハ、チップ、基板、パッケージに至るまで、先端半導体パッケージの全てのプロセスを網羅する検査ソリューションを提案いたします。また、近年需要が拡大しているパワー半導体向けの検査装置や搬送ロボットも併せて展示いたします。

〈出展概要〉

- ・会 期：2026 年 9 月 2 日(水)～9 月 4 日(金)
- ・会場：台湾台北南港展示センター（TaiNEX 1）
- ・ブース：Hall1 K3276

〈出展内容〉

- ・CIS・Memory 向け 2D MEMS プローブカード
- ・-40℃～200℃計測対応「TC プローブ」
- ・最先端デバイスに対応最小ピッチ 60 μm 「MEMS FLEX プローブカード」
- ・高電圧対応加圧構造「チャンバーヘッド プローブカード」
- ・ファインピッチ対応 40 μm 「Veri MEMS プローブカード」
- ・高電流対応 2,300mA「垂直型高電流プローブカード」
- ・FOPLP/RDL 向け高精度導通検査装置「GATS[®]-7886」
- ・大型個片半導体パッケージ向け高精度導通検査装置「GATS[®]-7837」
- ・半導体パッケージ多面付けフルパネル基板導通検査装置「GATS[®]-8370」
- ・狭ピッチ対応治具ソリューション「NS プローブ」
- ・ウェハバンプ対応光学式 2D/3D 検査装置「RWi シリーズ」
- ・高密度基板対応 2D/3D 検査装置「RSH シリーズ」
- ・光モジュール・大型基板対応次世代 AI 外観検査装置「AURCA Series」
- ・TGV (Through Glass Via) 向け高精度検査ソリューション
- ・Wafer 搬送ロボットシステム「AVR SMV 3000」 ※ニデックインスツルメンツとの共同開発